

nMCS 便携式 PXIe 测控系列

HW-1363

符合 PXIe/PXI 总线标准规范
提供 HW-1363(G3)和 HW-1363(G2)可选
内置厚物科技 PXIe-9170 控制器

HW-1363(G3)

内置厚物科技 3U 6 槽 PXIe Gen3.0 高速背板
1 个 3U PXIe 系统槽和 5 个 3U PXIe/PXI 混合扩展槽
系统槽总带宽 16GB/s
每个扩展槽专用带宽 8GB/s

HW-1363(G2)

内置厚物科技 3U 6 槽 PXIe 背板
1 个 3U PXIe 系统槽和 5 个 3U PXIe/PXI 混合扩展槽
系统槽总带宽 16GB/s

兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA 等 PXIe/PXI 模块
内置系统状态监控管理软件 HMCSP
全铝镁合金加固紧凑型设计
特殊防撞包角及加固硅胶把手设计
13.3"高清显示屏 1920x1080 分辨率
多点电容触摸屏或工业电阻触摸屏
工业触摸板及防水硅胶键盘
内置 300W 测控电源（可选配 600W）
9V~36V 直流电源宽压输入（支持 28V 航空电源）
电源输入接头航插设计
PXIe 机笼内缩 45mm 设计
可灵活定制 IO 航插接口



HW-1363方案

业界首款国产高性能 3U 6 槽 PXIe 笔记本

HW-1363 是业界首款 13.3"内置 Intel® Core™ 6th 或 9th 或 11th Gen i7 四核八线程或六核十二线程或八核十六线程 CPU 嵌入式 PXIe 控制器、PXIe 背板、高清显示屏和加固机箱的测控笔记本，此 PXIe 笔记本采用专业的工业外观设计、全铝镁合金加固紧凑型设计，集成 13.3"高清显示屏、多点电容触摸屏或电阻触摸屏、工业触摸板、防水硅胶键盘和测控电源等，具有高集成、坚固、便携等特点，适用于各种恶劣的户内外环境或测试设备便携移动的复杂工况。

HW-1363(G3)

内置厚物科技高性能 3U 6 槽 PXIe 高速背板，基于 PCIe Gen3.0 技术，符合 PXIe/PXI 总线标准规范，具有 1 个 3U PXIe 系统槽和 5 个 3U PXIe/PXI 混合扩展槽（兼容 PXIe 和 PXI 模块），系统槽总带宽 16GB/s，扩展槽专用带宽 8GB/s。

HW-1363(G2)

内置厚物科技高性能 3U 6 槽 PXIe 背板，基于 PCIe Gen2.0 技术，符合 PXIe/PXI 总线标准规范，具有 1 个 3U PXIe 系统槽和 5 个 3U PXIe/PXI 混合扩展槽（兼容 PXIe 和 PXI 模块），其中第 2 槽带宽 4GB/s，第 3 槽带宽 4GB/s，第 4 槽带宽 4GB/s，第 5 槽带宽 2GB/s，第 6 槽带宽 2GB/s，系统槽总带宽为 16GB/s。

HW-1363 兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等 PXIe/PXI 模块。机器内置系统状态监控管理软件 HMCSP，可实时监控机器内电源各分路电压、机箱内部温度和风扇转速等，支持 PWM 风扇转速控制，根据机箱内部温度高低风扇自适应调整转速对控制器及模块进行散热。

HW-1363 充分利用 PXIe/PXI 总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点，根据项目应用不同，此 PXIe 笔记本可内置各种不同的 PXIe/PXI 模块，实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量，用户可以在此便携测控平台上快速搭建各种测量、测试及控制系统，适用于军工国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等野外实战应用场合和科学试验研究场合。

深圳市厚物科技有限公司

SHENZHEN HOUWU TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市宝安区松岗芙蓉路 9 号桃花源科技创新园 B 栋四楼

0755-29982022

houwu.com.cn

操作系统	Windows® 7 Professional （选项 1、选项 2） Windows® 10 Professional （选项 1、选项 2、选项 3、选项 4、选项 5）	
处理器	Intel® Core™ 6 th Gen i7-6822EQ 2.0GHz (8MB Cache, up to 2.8GHz) Intel® Core™ 6 th Gen i7-6820EQ 2.8GHz (8MB Cache, up to 3.5GHz) Intel® Core™ 9 th Gen i7-9850HL 1.9GHz (9MB Cache, up to 4.1GHz) Intel® Core™ 9 th Gen i7-9850HE 2.7GHz (9MB Cache, up to 4.4GHz) Intel® Core™ 11 th Gen i7-11850HE 2.6GHz (24MB Cache, up to 4.7GHz)	四核八线程（选项 1） 四核八线程（选项 2） 六核十二线程（选项 3） 六核十二线程（选项 4） 八核十六线程（选项 5）
内存	16GB DDR4（可升级为 32GB/64GB）	
存储	独创性双固态硬盘 SSD 设计： 1, NVMe 250GB SSD x1（系统盘）（可升级为 1TB/2TB/4TB） 2, SATA3.0 1TB SSD x1（数据盘）（可升级为 2TB/4TB/8TB）	
链路配置	HW-1363(G3)配套控制器 PCIe Gen3.0 规范 2 Link 模式：PCIe3.0 x8 + PCIe3.0 x8 HW-1363(G2)配套控制器 PCIe Gen3.0 规范 4 Link 模式：4 x PCIe3.0 x4	
显示	13.3"高清显示屏，1920x1080 分辨率	
触摸屏	多点电容触摸屏 / 电阻触摸屏（可选）	
背板	HW-1363(G3) 3U 6 槽 PXIe 背板，基于 PCIe Gen3.0 技术 1 个 PXIe 系统槽和 5 个 PXIe/PXI 混合扩展槽 系统槽总带宽 16GB/s，5 个扩展槽带宽均为 8GB/s HW-1363(G2) 3U 6 槽 PXIe 背板，基于 PCIe Gen2.0 技术 1 个 PXIe 系统槽和 5 个 PXIe/PXI 混合扩展槽 系统槽总带宽 16GB/s，第 2 槽带宽 4GB/s，第 3 槽带宽 4GB/s，第 4 槽带宽 4GB/s，第 5 槽带宽 2GB/s，第 6 槽带宽 2GB/s	
IO 接口	LAN x2, USB3.0 x4, USB2.0 x2, RS232 x1, DP x2, VGA x1, SMB x1, RESET x1, LED x4 PXIe/PXI 机笼内缩 45mm, IO 航插接口适配器面板区域为 285mm x 86mm	
键盘	防水硅胶键盘	
IO 航插	用户可为 PXIe/PXI 模块灵活定制 IO 航插接口	
散热	风扇支持 PWM 工作模式，自适应调速，主动散热，符合 PXIe/PXI 总线标准规范	
电源	标配电源 9V~36V 直流宽压输入，航插接头 配专用电源适配器 330W：输入 AC 100V~240V，输出 DC 24V / 13.75A 额定带载 300W 选配电源 85VAC~264VAC 交流输入，航插接头 针对大功率射频类模块 额定带载 600W	

环境	工作温度： 0°C ~ 50°C（常温级） 工作温度： -20°C ~ 60°C（宽温级） 存储温度： -40°C ~ 70°C 相对湿度： 5% ~ 95%（无凝露）
抗冲击	30G 峰值，半正弦，11ms 脉冲
抗振动	2.4Grms@5~500Hz（X、Y、Z 三方向各 1 小时）
尺寸	370 x 308 x 134 mm（不含包角及把手）
重量	HW-1363G3) 11.6KG（含厚物科技 PXle-9170 控制器） HW-1363(G2) 11.4KG（含厚物科技 PXle-9170 控制器）
包装	定制配套航空拉杆箱
类型	nMCS 便携式 PXle 测控系列

注意：由于产品定期升级，如需更准确的规格配置信息，请联系厚物科技 0755-29982022